

## 北京赛微电子股份有限公司

### 2024 年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；

2、业绩预告情况：预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为负值，预计本报告期扣除非经常性损益后的净利润为负值。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：13,987.78 万元~19,168.44 万元	盈利：10,361.32 万元
	比上年同期下降：235%~285%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：15,404.80 万元~20,585.46 万元	盈利：815.34 万元
	比上年同期下降：1,989%~2,625%	
营业收入	116,971.44 万元~129,968.27 万元	129,968.27 万元
扣除后营业收入	111,736.33 万元~124,151.48 万元	124,151.48 万元
基本每股收益	亏损：0.19 元/股~0.26 元/股	盈利：0.14 元/股
MEMS 业务收入	98,411.90 万元~102,690.68 万元	85,575.56 万元
其中：		
瑞典 FAB1&2 的 MEMS 业务收入	80,538.68 万元~84,199.53 万元	73,216.98 万元
北京 FAB3 的 MEMS 业务收入	17,124.10 万元~18,161.93 万元	10,378.24 万元

注：“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

#### 二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公

司与年报审计会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

### 三、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动的主要原因为：

1、公司聚焦发展主营业务MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems，即微电子机械系统，简称为微机电系统），在工艺开发与晶圆制造方面均具备突出、领先的全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队，并基于在境内外已布局的产能，较好地把握了下游通讯、生物医药、工业汽车、消费电子等应用领域的市场机遇，公司MEMS业务订单持续增长，生产与销售保持活跃状态。

2、公司瑞典MEMS产线（FAB1&2）于2023年完成收购产线所在的半导体产业园区后，为业务扩展提供了可预期的空间条件，进一步巩固扩大了与各应用领域客户的业务合作关系，瑞典产线的营业收入较上年继续实现增长，盈利能力得到进一步提升。

3、公司北京MEMS产线（FAB3）的产能爬坡持续推进，除继续开展具有导入属性的工艺开发业务外，从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加，晶圆制造业务的数倍增长支撑了北京产线的营业收入较上年继续实现大幅增长；但由于在晶圆品类丰富背景下研发投入增加、工厂产能继续扩充建设，工厂运营支出进一步扩大，叠加折旧摊销因素，北京产线的亏损扩大，抵消了瑞典产线的盈利增长，导致公司MEMS主业整体亏损。

4、随着国内半导体设备市场及卫星导航市场的竞争加剧，公司半导体设备销售及卫星导航业务均下降超过了50%，未能如上年为公司贡献盈利。

5、公司持续增加对MEMS业务的投入，本报告期内销售费用、管理费用、财务费用增长，研发费用则在上期3.57亿元的水平上进一步增长，继续保持了较高的投入强度。

本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为1,417.02万元（主要影响因素为政府补助），上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为9,545.97万元（主要影响因素为政府补助）。

### 四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在

2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日